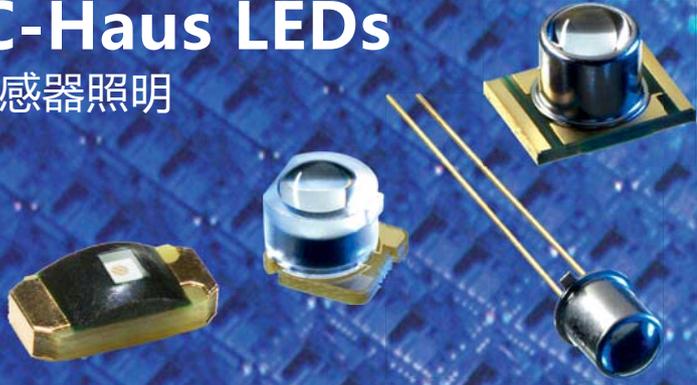


iC-Haus LEDs

传感器照明



iC-Haus LED 凭借其卓越的特性已被开发用于光学传感器和编码器应用，在这些应用中，需要优异的光束质量实现高对比度。

这些 LED 还可用于光学测距仪和调制光电传感器，这得益于高速开关特性。

坚固耐用的 LED 光源在高温操作和长期可靠性方面具有优异的性能。

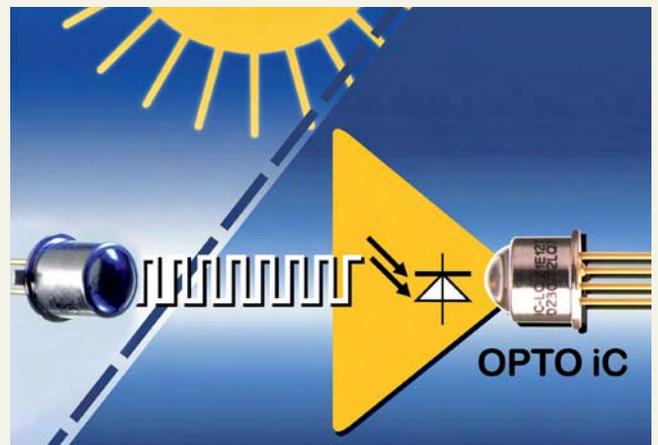
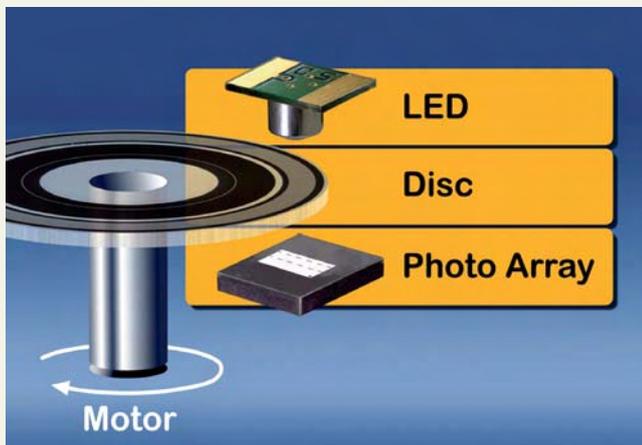
特性和应用

- 优化的辐射照度形式
- -40°C 至 +125°C 的高工作温度范围
- 高分辨率光电编码器的照明
- 调制光电传感器
- 光学测距应用

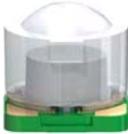
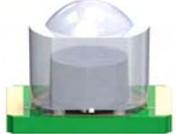
主要规格

LED	封装	光点尺寸	光功率 @ 20mA	波长	温度范围	光束角度
iC-TL6	BLCC2 1206	0.3 mm	3.5 mW	640 nm	-40°C 至 +125°C	140°
iC-TL46	TO46-2L1	3.4 mm	5.0 mW	460 nm	-40°C 至 +100°C	3.5°
	SD1C	3.4 mm	5.0 mW	460 nm	-40°C 至 +100°C	3.5°
iC-TL85	TO46-2L1	3.5 mm	1.8 mW	850 nm	-40°C 至 +125°C	4.5°
	TO46-2F1	/	2.7 mW	850 nm	-40°C 至 +125°C	朗伯辐射图
iC-SN85	SN1C	6.0 mm	8.1 mW	850 nm	-40°C 至 +125°C	3.0°
	SN2C	6.0 mm	8.1 mW	850 nm	-40°C 至 +125°C	3.0°
iC-SD85	SD1C	3.5 mm	1.8 mW	850 nm	-40°C 至 +125°C	4.5°
	SD2C	/	6.0 mW	850 nm	-40°C 至 +125°C	朗伯辐射图
	SD3C	3.5 mm	1.8 mW	850 nm	-40°C 至 +125°C	4.5°
iC-SG85	SG1C	8.0 mm	4.0 mW	850 nm	-40°C 至 +125°C	3.0°
	SG4C	8.0 mm	4.0 mW	850 nm	-40°C 至 +125°C	3.0°

应用示例



封装

iC-TL6  BLCC2 1206 3.2 mm x 1.6 mm x 1 mm	推荐的传感器 需要二次光学器件	iC-TL46  TO46-2L1 灯头 Φ 4.7 mm, 高度 5.39 mm	推荐的传感器 iC-LSB, iC-LSC iC-LSHB, iC-LSHC iC-PN 系列 iC-PNH 系列 iC-PD 系列 iC-PT H 系列
iC-SD85  SD1C 8 mm x 6 mm x 5.3 mm	推荐的传感器 iC-LSB, iC-LSC iC-LSHB, iC-LSHC iC-PN 系列 iC-PNH 系列 iC-PD 系列 iC-PT H 系列	 SD1C 8 mm x 6 mm x 5.3 mm	推荐的传感器 iC-LSB, iC-LSC iC-LSHB, iC-LSHC iC-PN 系列 iC-PNH 系列 iC-PD 系列 iC-PT H 系列
 SD2C 7.75 mm x 5 mm x 1.85 mm	需要二次光学器件	iC-TL85  TO46-2L1 灯头 Φ 4.7 mm, 高度 5.39 mm	推荐的传感器 iC-LSB, iC-LSC iC-LSHB, iC-LSHC iC-PN 系列 iC-PNH 系列 iC-PD 系列 iC-PT H 系列
 SD3C 7.7 mm x 6.3 mm x 4.89 mm	推荐的传感器 iC-LSB, iC-LSC iC-LSHB, iC-LSHC iC-PN 系列 iC-PNH 系列 iC-PD 系列 iC-PT H 系列	 TO46-2F1 灯头 Φ 4.7 mm, 高度 3.2 mm	需要二次光学器件
iC-SG85  SG1C 11 mm x 11.4 mm x 10.53mm	推荐的传感器 iC-LG iC-LGC	iC-SN85  SN1C 12 mm x 6 mm x 9.6 mm	推荐的传感器 iC-LNG iC-LNB
 SG4C 15.1 mm x 10.5 mm x 10.6mm	推荐的传感器 iC-LG iC-LGC	 SN2C 8.5 mm x 8 mm x 9.53 mm	推荐的传感器 iC-LNG iC-LNB

TO 封装：这些 LED 密封在金属封装中，可用于要求极其苛刻的环境。高耐湿度和温度循环。

COB 封装：这些 LED 被粘合到 PC 板 / 陶瓷基板上，并与高质量的模制非球面透镜组装在一起。可以定制具有板上芯片配置或特定孔径 / 光学器件的封装设计。

该初步信息不能作为器件的特性或性能的保证。iC-Haus 保留对技术更改的所有权。